

INVESTOR RELATIONS | FY 2026

Second Quarter Earnings

CONTENTS

01 Company Overview

02 Business Overview

03 Financial Result

04 Appendix

Disclaimer

본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편익을 위해 작성된 자료로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상' , '전망' , '계획' , '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로 당사는 이 자료의 내용에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

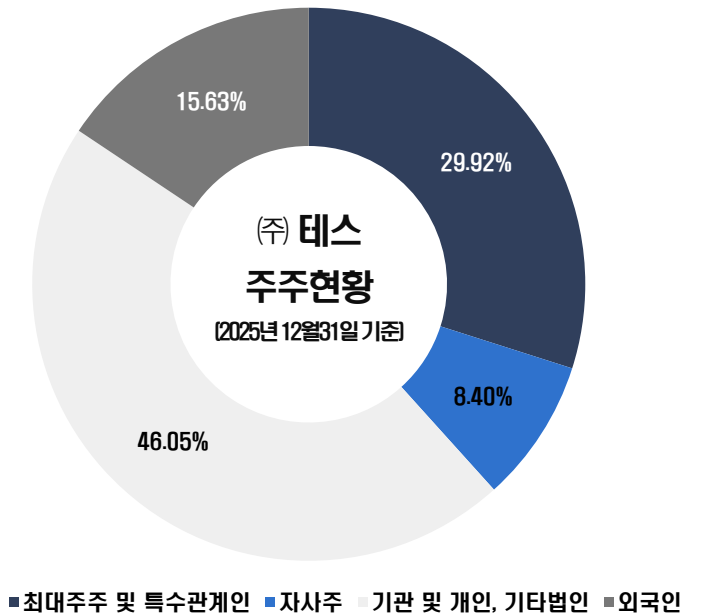
01. Company Overview

01 Company Overview

Overview



회 사 명	(주) 테스
설 립 일	2002.09.19
본 사	경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36
대표이사	이재호, 주재영
자본금	9,884 백만원
임직원수	472명(2026.06.30)
홈페이지	www.hites.co.kr
주요사업	반도체, 디스플레이, 화합물반도체 장비 제조업
상장정보	KOSDAQ (상장일 : 2008.5.20 / Code: 095610)



01 Company Overview

History

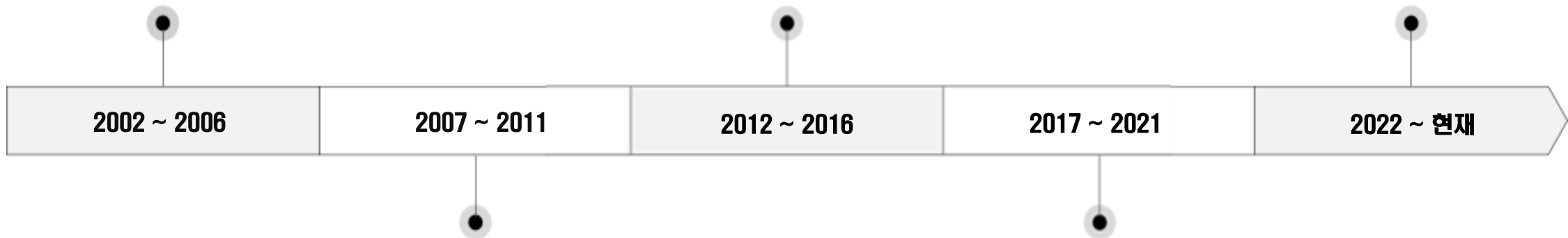
▪ 2002.09 (주)테스 설립

- 2004.10 본사이전 (주소: 용인시 처인구 양지면)
- 2005.04 300mm PE-CVD(반도체用) 개발

▪ 2012.04 반도체 GPE(Gas Phase Etcher)양산

- 2013.10 300mm 장비 100호기 출하
- 2015.05 코스닥 라이징스타기업 선정

- 2022.11 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 지정
- 2024.05 소재, 부품, 장비 으뜸기업 선정
- 2025.02 Technology Park(R&D Center) 신축
- 2025.07 라이징스타 명예의 전당 등재
- 2025.11 대한민국 코스닥대상 금융감독원 원장상 수상



▪ 2008.05 코스닥(KOSDAQ) 상장

- 2010.12 PECVD ACL장비 세계일류상품 선정

- 2017.11 (주)테스 원삼공장 가동(주소: 용인시 원삼면)
- 2021.12 제13회 대한민국 코스닥대상 수상
- 2021.12 연간 매출 3,700억원 달성

01 Company Overview

Location

사업장 [3]

용인 본사 (Semiconductor)

화성공장 (Display)

원삼공장 [MOCVD for DUV, SiC]

TES XIAN

HQ

TES WUXI

국내 C/S 센터[4]

이천, 평택, 동탄, 청주

HWASEONG FACTORY

ICHEON OFFICE

PYEONGTAEK OFFICE

해외 법인[2]

Xian, Wuxi in China

HQ

WONSAM FACTORY

DONGTAN OFFICE

CHEONGJU OFFICE

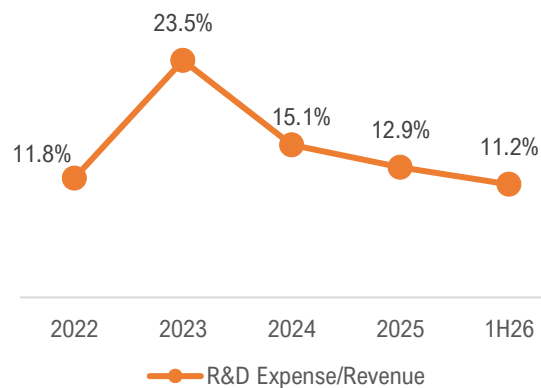
01 Company Overview

Factory	본사	원삼 공장	화성 공장
위치	용인시	용인(원삼면)	화성시
설립	2002	2017	2010
면적	8,585 m ²	2,919 m ²	3,597 m ²
생산제품	반도체장비 (CVD & Dry Cleaning)	반도체화합물장비 (Deep UV & SiC MOCVD)	디스플레이장비 (PECVD & ALD for TFE OLEDoS)
Capacity	– 168 units/yr Semiconductor Fab – Semiconductor R&D Lab	– 25 units/yr – OE Fab & R&D	– 24 units/yr – Display Fab & R&D
외관			

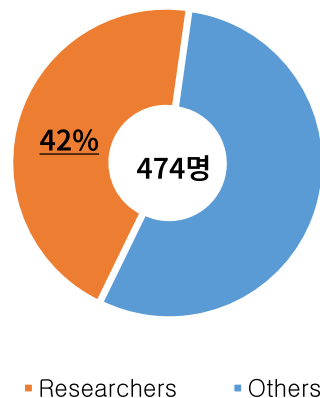
01 Company Overview

R&D Overview

R&D 비중



연구인력



주요 측정 장비

No	장비명	용도
1	SP - 5	Particle Measurement
2	TOF-SIMS	Analysis of Physical Properties
3	SEM	Surface Measurement
4	Nano Indenter	Thin film surface analysis
5	XRD	Structural Properties Measurement
6	FT-IR	Thin film composition analysis
7	Ellipsometer	Thin film thickness measurement
8	Particle Counter	Particle Measurement
9	4 Point Probe	Thin film resistance measurement
10	Mercury Probe	C-V measurement
11	Wise Probe	V-I measurement
12	Smartest QMS	Gas analysis
13	Stress Gauge	Thin film stress measurement
14	LEI	Sheet Resistance Measurement
15	PL	Optical Properties Measurement
16	EL	Analysis of Electro Luminescence
17	ATLAS	Thin film thickness measurement
18	RGA	Gas analysis
19	MBIR	Thin film thickness measurement

시설

제조설비 (CLASS 1000)



R&D (CLASS 100)

신규 R&D center
20,304m² (총 6개 층)

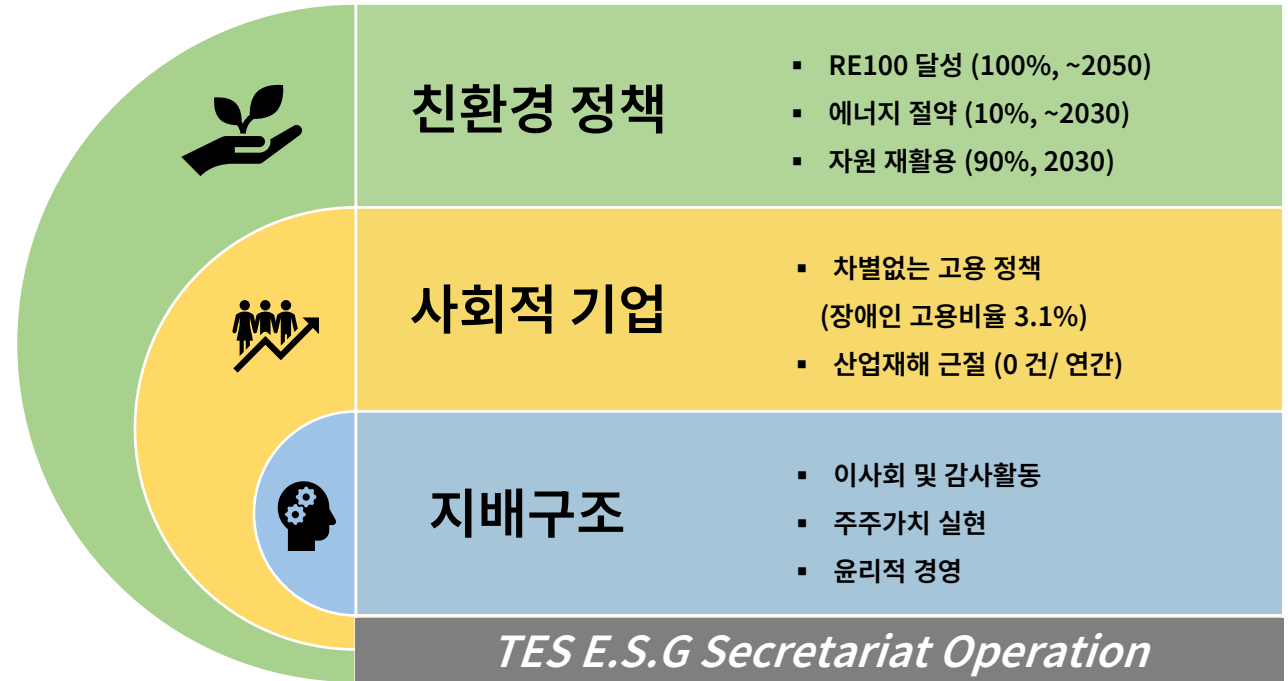


01 Company Overview

Certifications / ESG

인증 목록	
No	인증 / 사양
1	ISO9001
2	ISO14001
3	ISO45001
4	ISO50001
5	EMC Test
6	IEC 61439-2 Test
7	IEEE std. Test
8	SEMI F47
9	SEMI S2 / S8
10	SEMI S6

“2030년까지 탄소 배출량 15% 감축 및 2050년까지 Net Zero 달성”



TES ESG 등급 (2025, *KCGS)

구분	등급
종합	C
Environmental	B
Social	B+
Governance	C

*KCGS : Korea institute of Corporate Governance and Sustainability (한국ESG기준원) / 총 평가대상: 1,090사 (유가 805사, 코스닥 219사, 비상장 66사)

02. Business Overview

The background is a solid blue color with a subtle, light blue grid pattern. A thick, dark blue curved line sweeps across the lower half of the image, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and professional.

02 Business Overview

Products

사업분야	Application	주요고객	경쟁사	주요 제품
Semiconductor	Memory	삼성전자 SK하이닉스	AMAT Lam Research	PECVD(Advanced ACL, Arc, Gap Fill, Low-K) BSD System(BackSide Deposition) EUV Layer System
	Logic	삼성전자	TEL	Quad System(SiCN/SiN) Dry Cleaning(GPE/RPE)
Display & UV LED		Tianma, CSOT, 삼성D Epistar, Osram	AMAT, AMEC Axitron	OLEDoS For XR UV-MOCVD Power Semiconductor(SiC/RF GaN Epi)

02 Business Overview

Product Overview

PE CVD

- Adv-ACL, ARC
- Gap Fill, EUV Layer
- SiCN, BackSide Deposition, Low-K



Dry Clean

- GPE(Gas Phase Etch)
- RPE(Radical Plasma Etch)
- ALE(Atomic Layer Etch)



Semiconductor

Display



Encapsulation PECVD

- OLEDoS For XR (AR & VR)

**Opto
Electronics**



High Temperature MOCVD

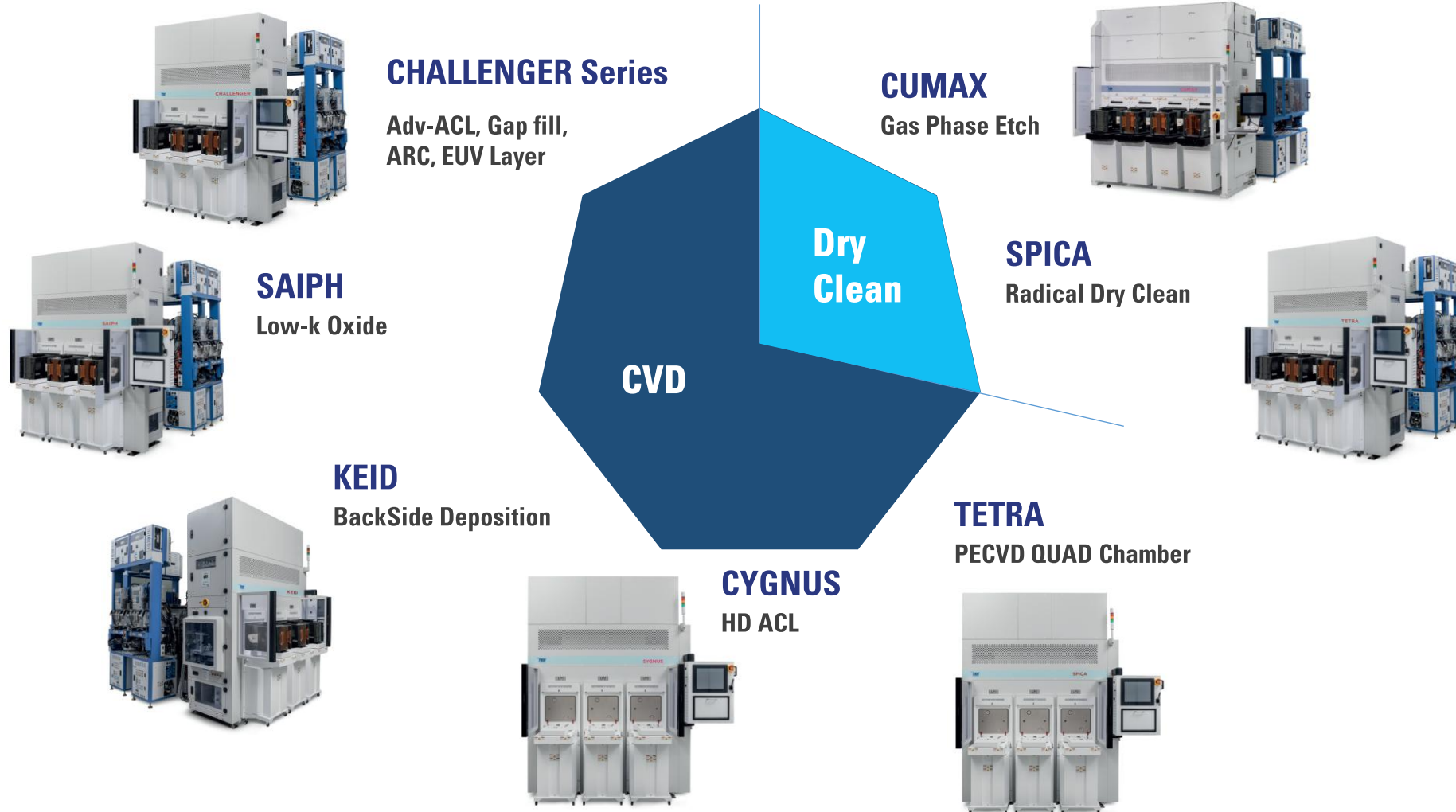
- Power Semiconductor(SiC/GaN)
- Deep UV LED (UVB, UVC)

TES

**Manufacturing
Systems**

02 Business Overview

Semiconductor Equipment



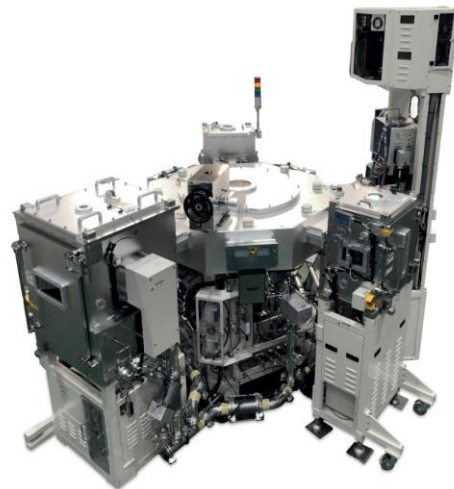
02 Business Overview

OED Equipment



SiC MOCVD

Power semiconductor
(EV, PSU, RF, Data Center)



PECVD

XR(AR & VR) Micro OLED &
LED (8 inch & 12inch)

OED Division

DUV MOCVD

UVB & UVC LED epitaxy
growth

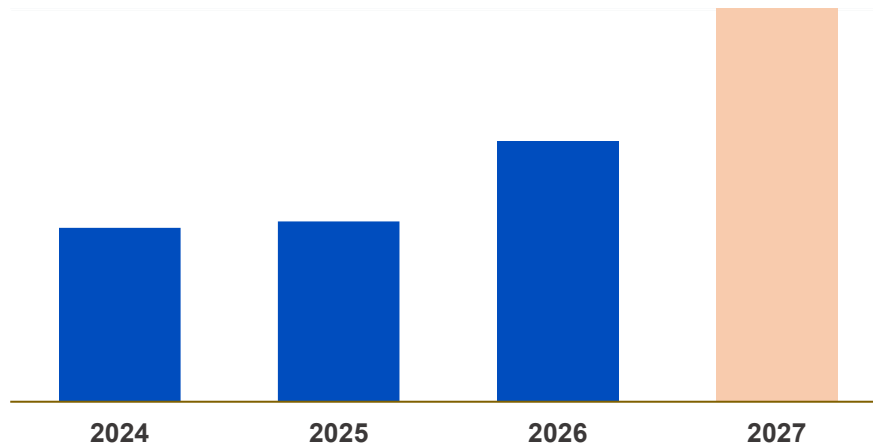


02 Business Overview

Memory 반도체 ACL 장치 글로벌 과점 지위 확보 및 Adv. ACL 등 지속 증가

추정 환산 기준 : 2024년 → 2027E 점유율 상승

메모리 반도체 ACL Market Share(추정 %)



- 01 선단 공정 전환
- 02 Global Market Share 상승
- 03 적극적인 해외 Marketing

DRAM/NAND 합산 ACL 장비 글로벌 M/S 30%+ 과점 지위 확보 및 점유율 확대 전망

Source: TES Estimate / TrendForce

주: DRAM/NAND 글로벌 시장 비중과 TES ACL M/S를 적용한 추정치. 실제 장비 TAM 및 투자 mix에 따라 변동 가능.

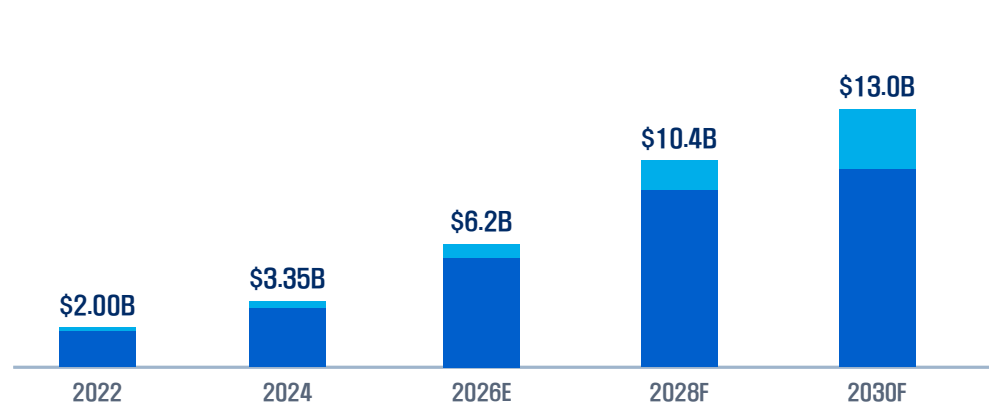
02 Business Overview

전력반도체 고성장 사이클 대응 SiC/GaN EPI 성장 장비 개발

Power SiC · Power GaN 시장 확대와 GaN EPI 구조 변화 → 매출 다각화

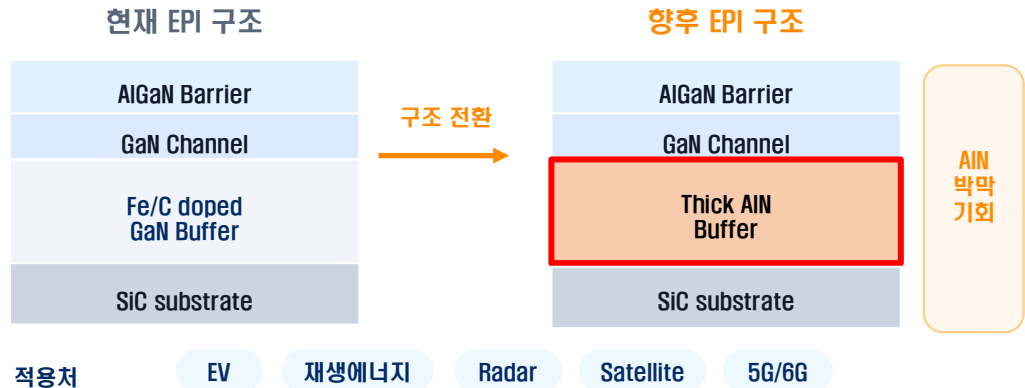
전력반도체(SiC/GaN) 시장 성장

시장 규모 (\$B)



GaN EPI 구조 변화: AlN 박막 수혜 포인트

고주파/전력 GaN 성능 고도화 과정에서 Buffer 구조 변화 → New Biz 기회



- 1 장비 개발**
SiC/GaN EPI 성장 장비
- 2 시장 확대**
Power SiC · Power GaN 고성장
- 3 구조 변화**
GaN EPI 내 AlN Buffer 채택
- 4 수혜 가능성**
EPI/박막 공정 장비 수요 증가

SiC/GaN EPI 장비 개발을 통해 전력반도체 성장과 AlN 박막 전환의 동시 수혜

Source: Yole 2025 / TES 자료

03. Financial Result

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, light blue grid pattern that covers most of the frame. A prominent, thick, curved line, resembling a stylized 'C' or a swoosh, is positioned horizontally across the middle of the slide. The line has a slight 3D effect with a darker blue shadow on its underside. The overall aesthetic is modern and corporate.

03 Financial Results

2Q26 Earning Highlights

매출

1,237억원

+ 50.7% YoY

영업이익

260억원

+ 27.8% YoY

영업이익률

21.0%

▲ 2%p YoY

주당 순이익

1,885원

+ 75.0% YoY

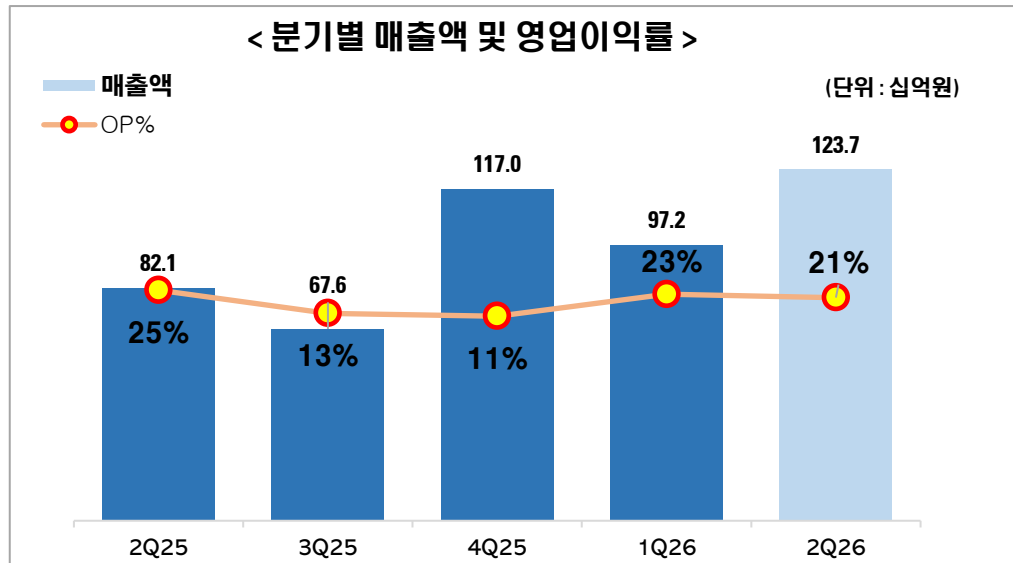
03 Financial Results

2Q26 Result

26년 2분기 실적

■ 메모리 고객사 신규 Fab 및 Tech 전환 투자

- 매출액 1,237억원(QoQ +27.2%/ YoY +50.7%)
- 영업이익 260억원(QoQ +17.2%/ YoY 27.8%)
- 순이익 340억원(QoQ +38.5%/ YoY +80.1%)

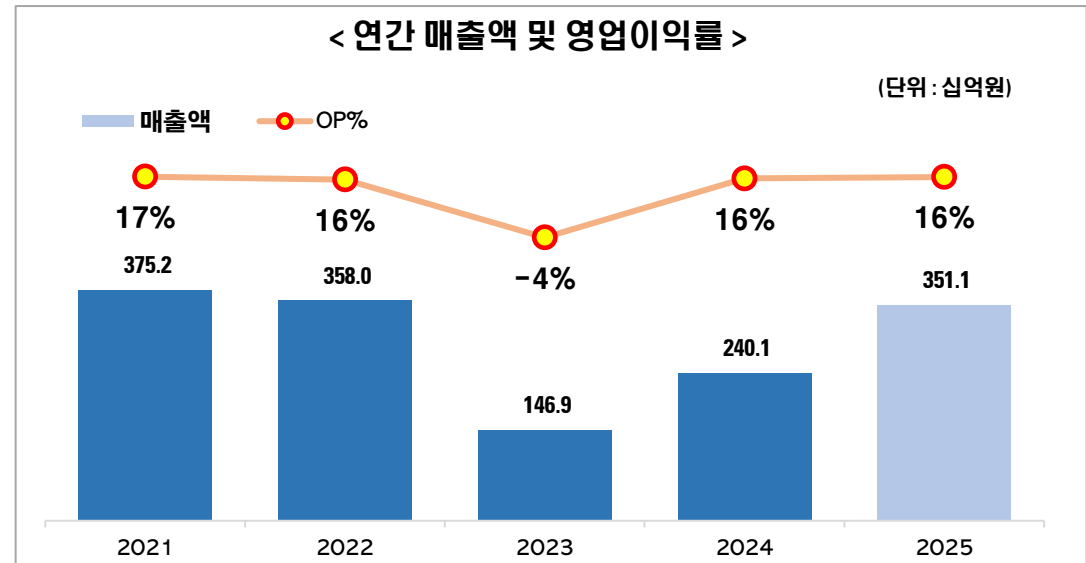


향후 전망 / 추진 전략

■ 26년 메모리 고객사 Tech 전환 및 신규 Fab 투자 지속

■ 신제품 개발 및 매출 증가

■ 해외 Marketing 강화 및 해외 고객사 매출 증가



03 Financial Results

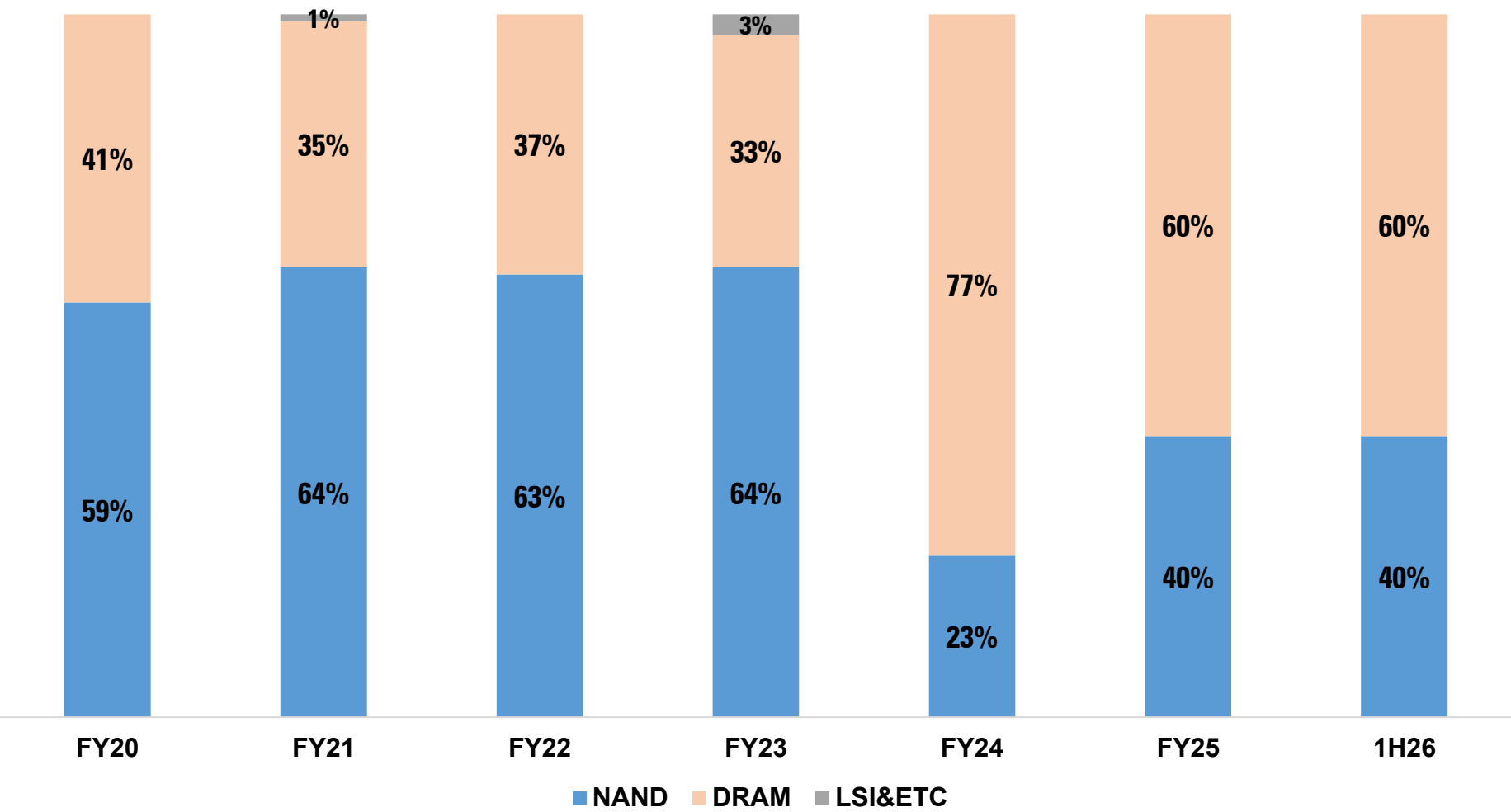
2Q26 Financial results

(단위: 백만원)

	2Q25	1Q26	2Q26	QoQ	YoY
매출액	82,064	97,243	123,671	27%	51%
영업이익(손실)	20,368	22,201	26,027	17%	28%
OP %	25%	23%	21%	△2%p	△4%p
법인세차감전순이익	21,625	28,778	42,945	49%	99%
당기순이익	18,897	24,576	34,030	38%	80%
주당순이익 (단위: 원)	1,077	1,382	1,833	33%	70%

03 Financial Results

Sales by Application



03 Financial Results

Competitive Edge

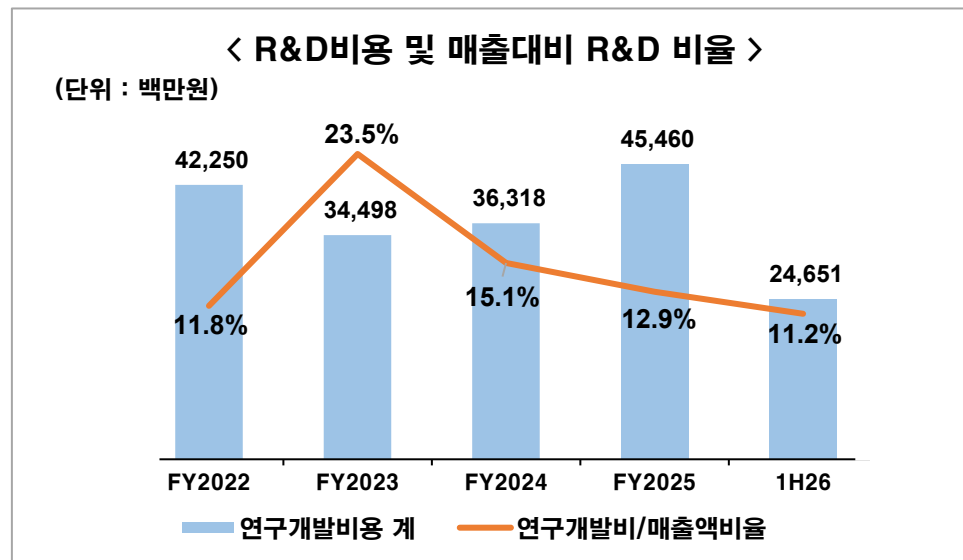
개발 지향

(1) Competitive edge

- PECVD & Dry Cleaning 장치 독보적 기술력 보유
- 우수한 품질, 가격, 서비스

(2) R&D 비율

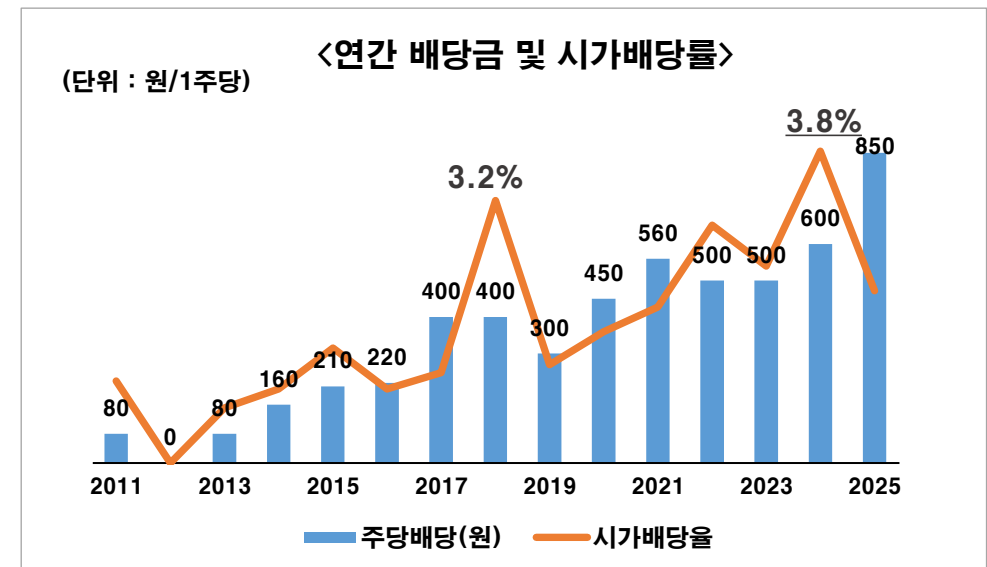
- 성장을 위한 R&D 지속
- 매출의 10% 이상 R&D



주주환원

(1) 주주배당

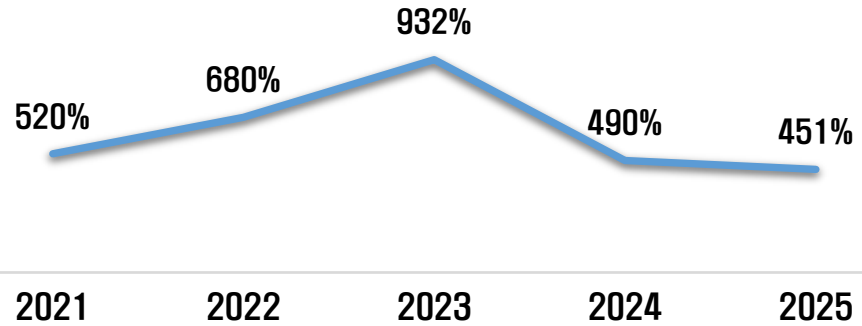
- 13년 연속 배당
- 배당금 및 시가배당을 장기 우상향



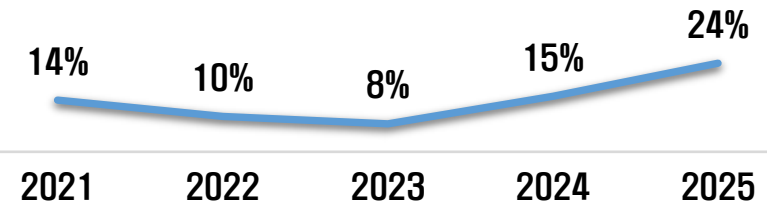
03 Financial Results

Financial Ratios

유동비율

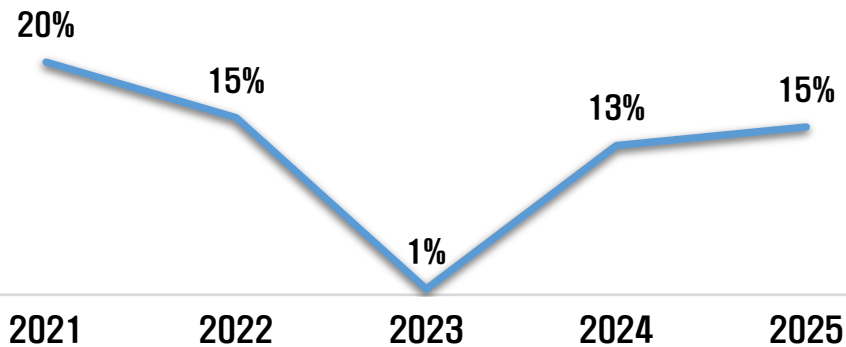


부채비율

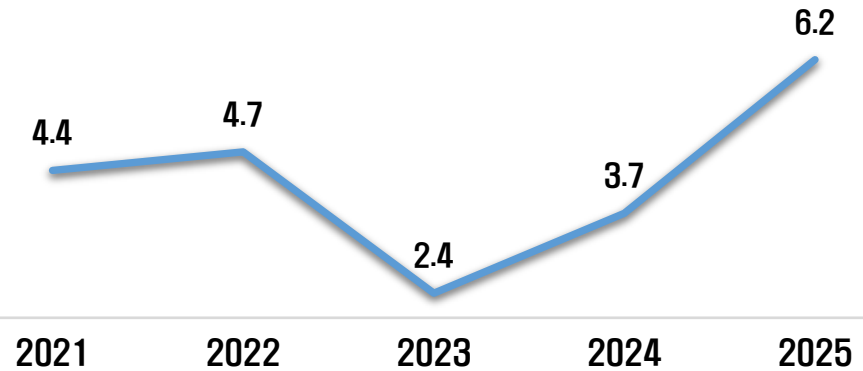


자기자본순이익률(ROE)

·상반기 반기순이익 연환산



재고자산회전율(회수)



04. Appendix

The background of the slide is a solid blue color with a subtle, light-colored grid pattern. A thick, dark blue curved line sweeps across the lower half of the image, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is clean and modern.

04 Appendix

Income Statement

(단위: 백만원)	2Q25	1Q26	2Q26	QoQ	YoY
매출액	82,064	97,243	123,671	27%	51%
매출원가	54,862	67,557	87,149	29%	59%
매출총이익	27,202	29,685	36,522	23%	34%
판매비와관리비	6,834	7,484	10,496	40%	54%
영업이익(손실)	20,368	22,201	26,027	17%	28%
영업외손익(Net)	1,257	6,577	16,919	157%	1,246%
세전이익	21,625	28,778	42,945	49%	99%
당기순이익	18,897	24,576	34,030	38%	80%
매출총이익률(%)	33%	31%	30%	△1%p	△3%p
영업이익률(%)	25%	23%	21%	△2%p	△4%p
당기순이익률(%)	23%	25%	28%	3%p	5%p

FY2023	FY2024	FY2025
146,938	240,078	351,116
134,131	175,503	259,011
12,807	64,574	92,104
18,669	26,101	34,266
△5,862	38,474	57,838
8,130	11,361	7,928
2,268	49,835	65,766
1,566	42,654	56,918
9%	27%	26%
△4%	16%	16%
1%	18%	16%

04 Appendix

Statement of Financial Position

(단위: 백만원)	2Q25	1Q26	2Q26	QoQ	YoY	FY2023	FY2024	FY2025
자산총계	415,609	538,498	565,943	5%	36%	321,830	381,187	487,649
유동자산	197,776	254,853	292,317	15%	48%	194,322	183,222	215,352
현금 및 현금성자산	31,713	67,187	65,864	△2%	108%	127,891	11,650	12,143
매출채권 및 기타채권	32,932	25,825	29,555	14%	△10%	12,217	38,458	26,948
재고자산	47,344	50,741	58,225	15%	23%	53,020	41,189	42,820
기타자산(유동)	85,787	111,100	138,673	25%	62%	1,194	91,925	133,441
비유동자산	217,832	283,645	273,626	△4%	26%	127,508	197,965	272,117
금융상품(비유동)	36,941	35,892	24,663	△31%	△33%	49,844	31,471	32,720
유무형자산	132,341	145,696	147,326	1%	11%	67,567	117,710	144,083
기타자산(비유동)	48,550	102,057	101,637	0%	109%	10,097	48,784	95,314
부채총계	60,627	128,463	98,309	△23%	62%	22,931	50,649	95,715
유동부채	50,138	87,141	82,529	△5%	65%	20,857	37,380	47,711
비유동부채	10,489	41,322	15,780	△62%	50%	2,074	13,269	48,004
자본총계	354,981	410,035	467,634	14%	32%	298,899	330,538	391,754
자본금	9,884	9,884	9,884	0%	0%	9,884	9,884	9,884
이익잉여금 등	345,097	400,151	457,750	14%	33%	289,015	320,654	381,870

Thank you

